

H200-Soft 超软系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

产品性能

| NO. | 参数 | 单位 | 测试方法 |
|------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 颜色 | 浅蓝色 | --- | 目视 |
| 厚度 | 0.8~3 | mm | ASTM D 374 |
| 硬度 | 20 \pm 5 | Shore 00 | ASTM D 2240 |
| 密度 | 2.4 \pm 0.5 | g/cc | ASTM D 792 |
| 拉伸强度 | ≥ 0.15 | Mpa | ASTM D 412 |
| 延伸率 | ≥ 70 | % | ASTM D 412 |
| 压缩比 | ≥ 50 (@50psi) | % | ASTM D 695 |
| 阻燃等级 | V-0,5V | --- | UL-94 |
| 使用温度 | -50~180 | $^{\circ}\text{C}$ | IEC 60068-2-14 |

热学特性

| | | | |
|------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 导热系数 | 2.0 \pm 0.3 | W/m \cdot K | ASTM D 5470 |
| 热阻 | ≤ 0.7 (@20Psi/1mm) | $^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$ | ASTM D 5470 |

电学特性

| | | | |
|-------|-------------|------------------------|------------|
| 击穿电压 | ≥ 8 | KV/mm | ASTM D 149 |
| 体积电阻率 | $\geq 10^8$ | $\Omega\cdot\text{cm}$ | ASTM D 257 |
| 介电常数 | ≥ 2 | @1MHz | ASTM D 150 |
| 介质损耗 | ≤ 0.1 | @1MHz | ASTM D 150 |

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权